

2.5mm Dia. Jacks

■ Features

1. A small, $\phi 2.5$ mm jack that was developed for small, mobile equipment.
2. Surface mounting and DIP types are available.

■ Specification

1. Electric Performance

Rating	: 1A, 12V DC
Contact Resistance	: 30m Ω max.
Insulation Resistance	: 100M Ω min.500V DC
Withstanding Voltage	: 500V AC(for one minute)

2. Mechanical Performance

Insertion Force	: 30N max. at 2.5mm Dia.gauge
Extraction Force	: 3 to 30N at 2.5mm Dia.gauge

■ Application

Smart phones, mobile phones, portable audio, other small AV equipments.

■ 特長

1. 小型携帯機器用に開発した $\phi 2.5$ mmの小型ジャックです。
2. 面実装タイプ、DIPタイプを揃えています。

■ 仕様

1. 電气的性能


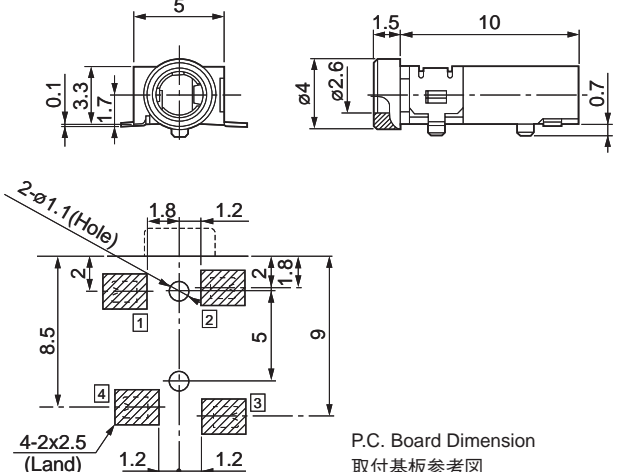
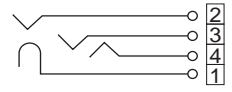

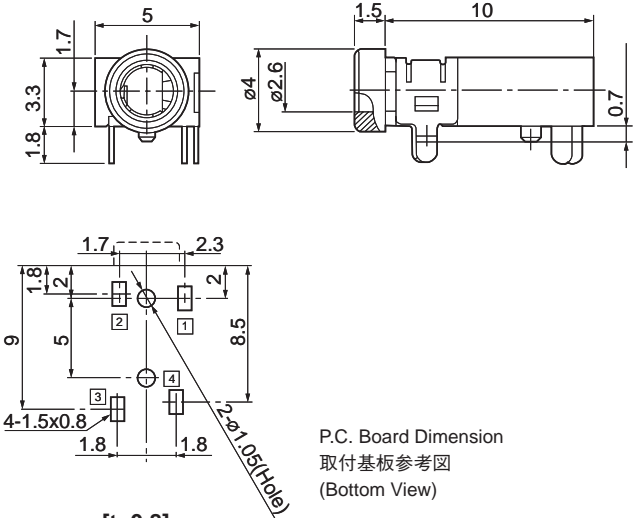
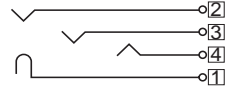
定格電圧電流	: DC12V 1A
接触抵抗	: 30m Ω 以下
絶縁抵抗	: DC500V 100M Ω 以上
耐電圧	: AC500V (1分間)

2. 機械的性能 (詳細は個別規格による)

挿入力	: $\phi 2.5$ mmゲージ 30N以下
抜去力	: $\phi 2.5$ mmゲージ 3 ~ 30N

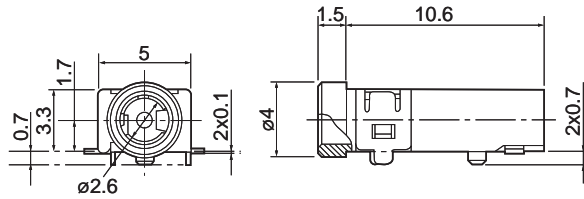
■ 用途

スマートフォン、携帯電話、ポータブルオーディオ、その他小型AV機器

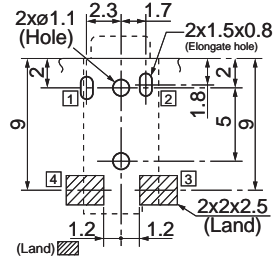
<p>LGK1709-1601F</p> 	 <p>P.C. Board Dimension 取付基板参考図 (Top View)</p> <p>(1,000pcs/reel)</p>	<p>Circuits / 回路</p> 
<p>SMD Type</p> <p>面実装タイプ</p>	<p>Reflow Soldering リフローはんだ</p>	
<p>LGK1709-2200F</p> 	 <p>P.C. Board Dimension 取付基板参考図 (Bottom View)</p> <p>[t=0.8]</p>	<p>Circuits / 回路</p> 
<p>DIP Type</p> <p>ディップタイプ</p>	<p>Manual Soldering 手はんだ</p>	

2.5mm Dia. Jacks

LGK1709-270□F



<input type="checkbox"/>	Boss
1	With
2	Without

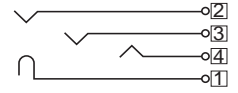


※ The front terminal of dip.
前面端子はディップです。
※ Shading Type / 遮光仕様

P.C. Board Dimension
取付基板参考図
(Top View)

(1,000pcs/reel)

Circuits / 回路



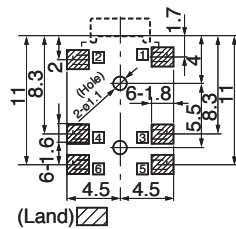
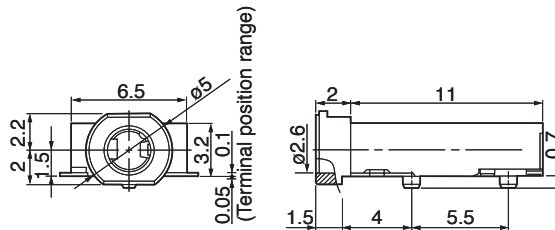
遮光仕様

Reflow Soldering
リフローはんだ

SMD Type

面実装タイプ

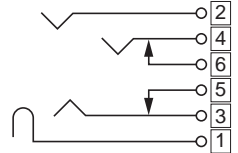
LGK1509-0901F



P.C. Board Dimension
取付基板参考図
(Top View)

(500pcs/reel)

Circuits / 回路

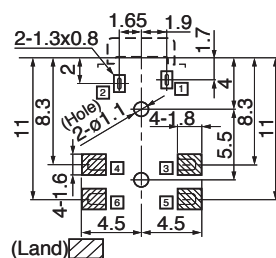
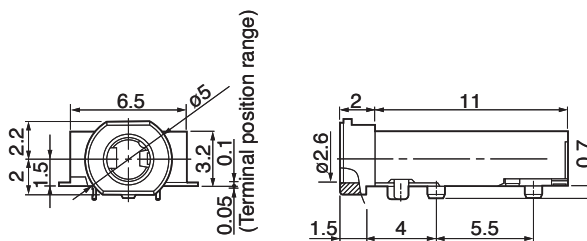


Reflow Soldering
リフローはんだ

SMD Type

面実装タイプ

LGK1509-1001F

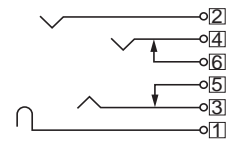


※ The front terminal of dip.
前面端子はディップです。

P.C. Board Dimension
取付基板参考図
(Top View)

(1,000pcs/reel)

Circuits / 回路



Reflow Soldering
リフローはんだ

SMD Type

面実装タイプ

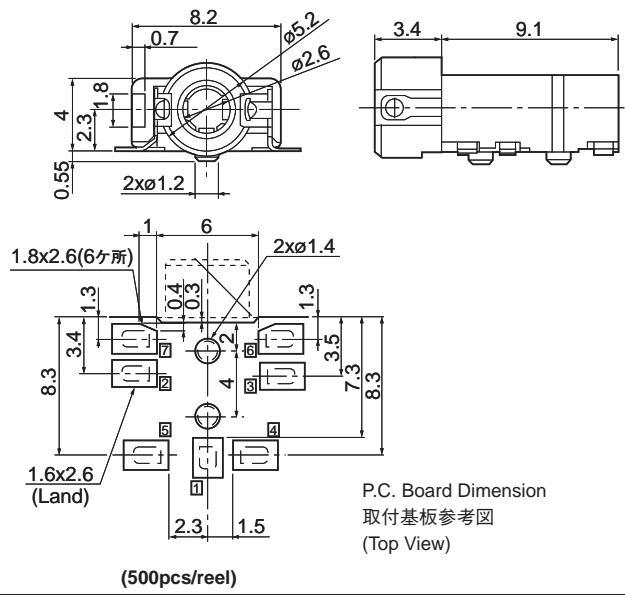
2.5mm Dia. Jacks

LGK2308-0801F

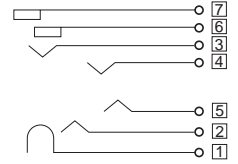


SMD Type

面実装タイプ



Circuits / 回路



Reflow Soldering
リフローはんだ